

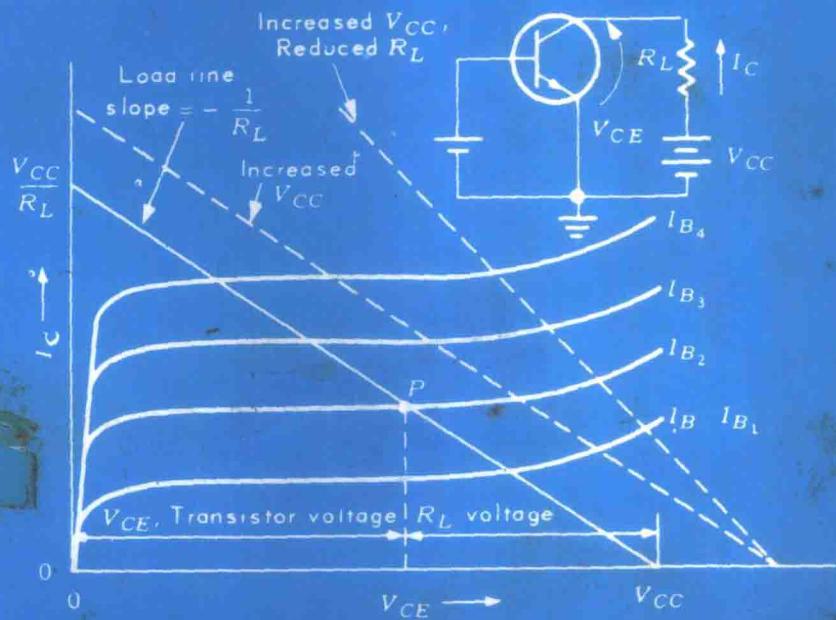
最新增訂本

電晶體電路 (全集)

TRANSISTOR
CIRCUIT
APPROXIMATIONS



Albert Paul Malvino, Ph.D. 原著



羅拔書局印行

最新增訂本
電晶體電路
全集

羅拔書局印行

電晶體電路全集

編譯者：陳 虞

出版 兼：羅 拔 書 局
發行

澳門大馬路 381 號二樓 F 座

印刷者：振興印刷公司
澳門龍嵩街 152 號地下

H. K. \$ 28.00

原序

我們使用電晶體時，必須瞭解所接觸之裝置並非十分精確可靠，這是由於電晶體的特性使然。例如：電晶體的重要參數之一的電流增益 β （亦用 h_{fe} 表示），我們若改換同一型號的電晶體， β 的變化最少也在 $2:1$ 範圍內。因為有此種變化，所以不可能精確預測該電晶體在某特定電路內究竟如何工作。而且， β 還會隨其周圍溫度之變動而變動，更使另一不準確度加入電路工作之中。

為消除電晶體電路所發生的大幅變化，可使用負回授或其他類似技術，減少其增益，以獲致較高的穩定工作。使用此一方法處理，電路工作幾與電晶體特性無關。換言之，使用足夠之負回授來穩定工作， β 之精確值及其他電晶體的特性已不重要。

簡言之，由於電晶體之精確特性不易獲知，我們想以精確公式來分析電晶體電路之值已受到限制。如果考慮電晶體之容許誤差，則可適當地使用近似解以分析多種不同的電晶體電路。本書大部份着重在理想電晶體近似解。所謂近似解即僅保留電晶體重要特徵的解法。應用近似解可使新手很快把握住電晶體電路如何工作。此一簡易近似解，適於大多數我們所遇到的電晶體之使用。

本書較後數章是討論理想電晶體近似解所摒除之某些二階效應。最後一章涉及 h 參數解法，因為此一技巧，至少在理論上，可求得較精確的答案。

本書可供初級學院或技術專校之電子技術人員的講授教材。對需求一本既實用而又淺易的電晶體書籍之電子界人士而言，本書最為適用。本書份量適合每週三小時教學之用，先修課目應具有代數與基本電學知識。

我很感謝時間系統公司(*Time System Corp.*)的梅好謀(*Daniel J Mindheim*)先生，對我撰寫本書時之指正，及愛美斯研究中心(*Ames Research Center*)的布如斯(*Clifford Burrus*)先生，仔細核閱最後書稿並提供許多有價值之建議。

阿伯特·波爾·馬爾維諾
(A.P. MALVINO)

增訂本全集序

「電晶體電路」一書由於內容切合高工及五專相關科系程度，先後被採作教科書者多達六十餘校，故自發行以來屢經再版，誠洛陽爲之紙貴。而唯一遺憾的是當年原著者 *Malvino* 博士未能將特殊半導體等有關資料列入書內。正值譯者爲此應如何增訂方始不負國內讀者們殷切期望之時，欣見原著者之增訂本問世。

增訂本係就原書第十四章後，增列“場效電晶體”、“特殊二極體”、“閘門裝置”及“光電裝置”四章合併成十八章之一完整巨著。前十四章部份，除增添些許習題問題外，內文則無隻字之更改。

本書譯成中文本「電晶體電路」，早有上、下冊及其合訂本之分，上冊爲前八章，下冊自第九章至第十四章，今將增訂之第十五章至第十八章添入合併成「增訂本全集」。

譯 者 謹

目 錄

第一章 半導體物理

1 — 1	銻與矽原子.....	1
1 — 2	銻與矽晶體.....	2
1 — 3	純質銻與矽之導電.....	3
1 — 4	電洞觀念.....	5
1 — 5	外質半導體.....	7

第二章 p · n 接頭二極體

2 — 1	p · n 接頭.....	13
2 — 2	p · n 接頭之整流性質.....	15
2 — 3	半導體二極體之電流電壓特性.....	17

第三章 大信號二極體近似解

3 — 1	理想二極體.....	25
3 — 2	實際二極體之第二近似解.....	31
3 — 3	實際二極體之第三近似解.....	34
3 — 4	利用二極體近似解.....	37
3 — 5	逆向電流近似解.....	38
3 — 6	齊納三極體.....	40
3 — 7	齊納二極體第二近似解.....	44

第四章 小信號二極體近似解

4 — 1	疊量定理.....	53
4 — 2	疊量定理用於電路中.....	55
4 — 3	二極體交流電阻.....	63
4 — 4	二極體交流電阻公式.....	65
4 — 5	使用疊量定理於二極體電路.....	70
4 — 6	逆向區域之二極體電容.....	75

第五章 共同基極近似解

5 — 1	術語與線路符號.....	85
-------	--------------	----

2 目 錄

5 - 2	電晶體之偏壓.....	87
5 - 3	共同基極電晶體電流電壓特性.....	89
5 - 4	電晶體之 Alpha.....	92
5 - 5	理想電晶體.....	94
5 - 6	使用重疊定理分析共同基極電路.....	100
5 - 7	複雜交流等效電路.....	103
5 - 8	共同基極分析公式.....	109
5 - 9	電壓與電流記號.....	118

第六章 共同射極近似解

6 - 1	共同射極連接電流電壓特性.....	127
6 - 2	電晶體之 Beta	130
6 - 3	理想共同射極電晶體.....	131
6 - 4	電晶體基極偏壓.....	135
6 - 5	電晶體射極偏壓.....	138
6 - 6	分析共同射極電晶體電路.....	144
6 - 7	射極偏壓級電壓增益.....	150
6 - 8	電源電阻效應.....	154
6 - 9	真空管與電晶體之轉換.....	157

第七章 共同集極近似解

7 - 1	共同集極連接基本觀念.....	169
7 - 2	導出共同集極公式.....	171
7 - 3	達靈頓 (Darlington) 一對.....	181

第八章 大信號工作

8 - 1	直流負載線.....	189
8 - 2	負載線解釋交流信號.....	197
8 - 3	交流負載線.....	200
8 - 4	獲得最大未剪波信號.....	206
8 - 5	p-n-p 負載線.....	210
8 - 6	共同射極連接之負載線.....	213
8 - 7	共同集極連接之負載線.....	217
8 - 8	陰極隨耦器交流負載線.....	220

第九章 偏壓安排

9 - 1	β 敏度之觀念.....	229
-------	--------------------	-----

9 - 2	基極偏壓.....	231
9 - 3	射極回授之基極偏壓.....	234
9 - 4	集極回授之基極偏壓.....	238
9 - 5	集極與射極回授之基極偏壓.....	243
9 - 6	二電源供給之射極偏壓.....	247
9 - 7	單一電源供給之射極偏壓.....	253
9 - 8	靈敏度之比較.....	260
9 - 9	接地點之位置.....	261
9 - 10	P - N - P 位晶體之偏壓.....	264

第十章 交流工作

10 - 1	共同射極工作.....	277
10 - 2	共同射極電路之交流分析.....	279
10 - 3	射極回授.....	288
10 - 4	共同集極工作.....	296
10 - 5	共同基極工作.....	300
10 - 6	信號電源電阻效應.....	304
10 - 7	穩定信號電源至輸出之電壓增益.....	307
10 - 8	P - N - P 工作.....	312
10 - 9	接地點.....	313
10 - 10	最大信號攝取能力.....	314

第十一章 串 級

11 - 1	電阻電容交流.....	327
11 - 2	二級回授.....	334
11 - 3	電感交連.....	340
11 - 4	變壓器交連.....	342
11 - 5	調諧放大器.....	347
11 - 6	直接交連放大器.....	350

第十二章 溫度效應

12 - 1	射極接頭電阻之改變.....	361
12 - 2	β 之改變.....	363
12 - 3	V_{eg} 之改變.....	364
12 - 4	基極接地電路之洩漏電流.....	367
12 - 5	射極接地之洩漏電流.....	372
12 - 6	穩定因素.....	375

4 目 錄

第十三章 頻率響應

13 — 1	電阻電容交連放大器之響應.....	387
13 — 2	典型共同基極級之低頻截止.....	388
13 — 3	共同基極級之高頻截止.....	392
13 — 4	共同射極放大器低頻截止.....	396
13 — 5	電晶體截止頻率.....	400
13 — 6	基極分佈電阻.....	403
13 — 7	共同射極級高頻限制.....	405
13 — 8	串級響應.....	409

第十四章 h 參數

14 — 1	h 參數觀念.....	417
14 — 2	網路之輸入阻抗.....	423
14 — 3	使用 h 參數之電壓增益.....	427
14 — 4	電晶體之 h 參數.....	429
14 — 5	理想共同集極電晶體之 h 參數.....	432
14 — 6	理想共同射極電晶體之 h 參數.....	436
14 — 7	h 參數之轉換.....	441
14 — 8	對 h 參數之實際觀察.....	443

第十五章 場效電晶體

15 — 1	接頭場效電晶體.....	449
15 — 2	JFET 淩極曲線組.....	450
15 — 3	JFET 的偏壓.....	453
15 — 4	JFET 的交流操作.....	456
15 — 5	源極隨耦器.....	459
15 — 6	空乏 - 增強型MOSFETs.....	460
15 — 7	增強型MOSFETs.....	464
15 — 8	MOSFETs的偏壓.....	465
15 — 9	MOSFETs電路的交流分析.....	467
15 — 10	FET 與雙極電晶體的對比.....	469

第十六章 特殊二極體

16 — 1	變抗二極體.....	477
16 — 2	步級回復二極體.....	479
16 — 3	蕭特基二極體.....	482

16 — 4	反向二極體.....	483
16 — 5	透納二極體.....	484
16 — 6	p-i-n 二極體.....	486

第十七章 閘閂裝置

17 — 1	理想閘閂.....	495
17 — 2	四層二極體.....	500
17 — 3	矽控整流器(SCR).....	505
17 — 4	其他類的SCR.....	512
17 — 5	矽控開關(SCS).....	513
17 — 6	Diac.....	515
17 — 7	Triac.....	516
17 — 8	單接頭電晶體(UJT).....	518
17 — 9	UJT電路.....	522

第十八章 光電裝置

18 — 1	光射二極體.....	531
18 — 2	光射二極體的排列.....	533
18 — 3	雷射二極體.....	534
18 — 4	光電阻.....	539
18 — 5	光二極體.....	540
18 — 6	光電晶體.....	542
18 — 7	光偵測器的排列.....	545
18 — 8	光隔絕器.....	546
	參考書目.....	553
	問題答案.....	555
	希臘符號.....	569
	索引.....	572

第一章 半導體物理

本書全篇主旨旨在於討論各種電路中電晶體(*transistor*)的應用情形，然而最要緊的是在開始討論之前，我們必須考慮一些原子理論(*atomic theory*)的基本觀念，在本章中我們討論半導體(*semiconductor*)，自由電子(*free electron*)，電洞(*hole*)，與摻雜(*doping*)，這些資料將使我們很容易瞭解電晶體如何實際工作。我們將發展出若干簡單的近似解法，以對這些電路給與快速而簡易的分析。

I — I 鑄(germanium)及矽(silicon)原子

本節我們研究鑄(*Ge*)與矽(*Si*)之原子結構，因為這些物質在製造電晶體時將廣泛使用。

我們大都知道所有物質均由原子所構成，而原子包括原子核(*nucleus*)及環繞其周圍旋轉之電子。假如我們檢視一隔離之鑄原子，就會發現原子核中含有32個質子(*protons*)，此原子在正常狀態時，有32個電子環繞着原子核旋轉，並且這些旋轉之電子，其分配有固定之圖形與位置，通常稱為殼層(*shells*)。

圖1-1(a)用符號說明一鑄原子，中心為原子核，有32個質子，旋轉之電子分配於不同之殼層，依下列之型式：

$$2, 8, 18, \dots\dots 2n^2$$

*n*為殼層數，換言之，第一殼層有電子2個，第二殼層有8個，第三殼層有18個，最後4個電子在第四殼層，或稱外部(*outer*)殼層由類似之途徑，我們可發現一單獨之矽原子，其原子核中有14

2 電晶體電路

個質子，當此原子在正常狀態，有 14 個旋轉之電子，如圖 1-1(b) 所示，第一殼層包含 2 個電子，第二殼層包含 8 個電子，4 個剩餘電子在矽原子之第三或外部殼層。

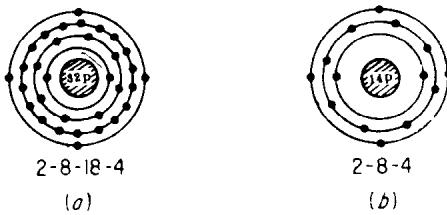


圖 1-1 (a) 錫 (b) 矽

我們主要興趣在於錫與矽原子之外部殼層，所以我們簡化這些原子之圖形。圖 1-2 (a) 僅顯示錫原子之外部殼層，而此圖之內部稱為錫核 (*germanium core*)，包括原子核與內部殼層。同理，矽原子可如圖 1-2 (b)，顯示矽核由外部殼層之四個電子環繞着。

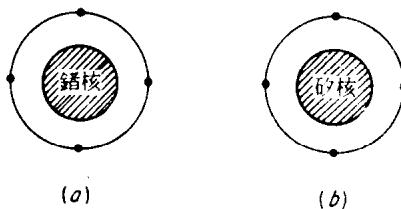


圖 1-2 (a) 錫與(b) 矽之外部殼層

1 — 2 錫與矽晶體 (crystal)

上節我們討論單獨之錫與矽原子，現在討論多個錫及矽原子如何組合形成一固態之錫與矽。

讓我們首先考慮錫，一單獨之錫原子外部殼層包含四個電子，此殼層不完整 (*incomplete*)，有八個電子才穩定。由實驗之事實得知，錫原子彼此間之組合，每一原子外部殼層都要有八個電子。

為完成此現象，原子之排列使其結構成為晶體(*crystal*)。當我們檢視純鎗之晶體時，會發現每一原子周圍有四個毗連原子(*neighboring atoms*)，實際上與中心原子共同均分電子。

圖1-3使此觀念更為清楚，中心原子外部殼層共有八個電子，其中四個電子屬於中心原子，另外四個電子由毗連的其他四個原子所供給，因為每一個毗連原子，實際上與中心原子共用一個外部殼層電子，而每一毗連原子也有四個鄰居，所以晶體內之每一原子其外部殼層有八個電子。

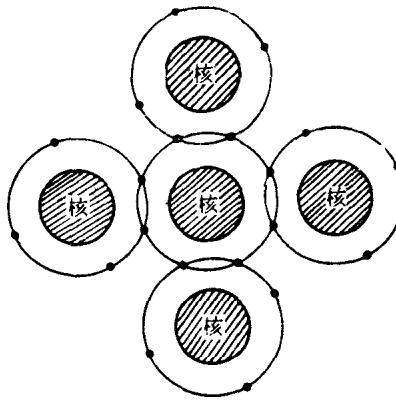


圖1-3 晶體內之原子

據此類推，許多數量之矽原子結合形成晶體，每一原子有四個鄰居，共用電子，故每一矽原子外部殼層共有八個電子。

我們將接受實驗之事實，鎗及矽原子之外部殼層電子數，一直到含有八個電子為止，否則均屬不完整。當少於八個電子時就有原子吸力存在，直至足夠之電子被加入到外部殼層完成八個電子。一旦外部殼層含有八個電子，這些電子被原子緊密束縛住，除非施加外力，不能夠脫逃。

I - 3 純鎗與矽之導電

4 電晶體電路

晶體之鉻或矽傳導電流情形如何？如欲回答此問題，考慮圖 1-4 (a)，顯示純鉻之晶體連接於電池兩端，當溫度為絕對零度時我們發現電路中無電流，理由是晶體內無自由電子，所以電子被晶體中原子緊密束縛住；個別原子之內部殼層電子被隱匿得很好，對於電流流通沒有貢獻；而外部殼層電子亦被原子緊密束縛而不能流通，故在絕對零度時鉻晶體為絕緣體。

當溫度上升，熱能 (*thermal energy*) 加入鉻晶體，此能量可實際移出一些外部殼層電子，使之可利用成為電流。被擊出外部殼層之電子稱做自由電子，在圖 1-4 (b) 中，自由電子用負號表示。這些電子可自由移動，受電池影響它們移向左邊，建立電流，此一電流通常很小，因為只有少數自由電子由熱能產生。

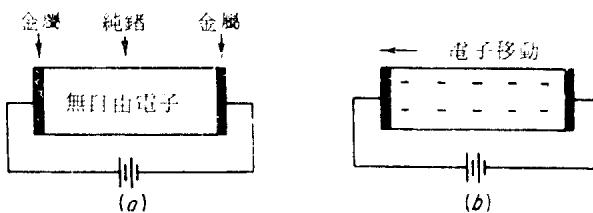


圖 1-4 (a) 絶對零度與(b)高溫時之導電

當然，如溫度增加更高，更多之電子從外部殼層釋放出來，結果產生更大電流。在室溫 (25°C 左右) 時，我們發現如考慮鉻為導體則電流量太小，如仍繼續稱為絕緣體，電流又太大。因此，我們稱鉻晶體為半導體。

至於矽晶體之電流行為與鉻晶體相同，在絕對零度所有電子被其原子緊密束縛，矽晶體如同絕緣體。當溫度上升，一些電子被擊出外部殼層，成為可利用之電流。不過矽之外部殼層電子較鉻束縛得緊，結果矽原子較鉻原子需要較多之熱能才能移出外部殼層電子。因此，我們注意矽與鉻間之一項重要差異：在相同溫度時，矽晶體之自由電子較鉻晶體為少。

I — 4 電洞觀念

在討論半導體時，有一重要之電洞 (*hole*) 觀念，為使此概念更為清晰，可注意圖 1-5。一典型之鎵原子（或矽）與四個毗連原子，如前所示，熱能可使電子從原子外部殼層移出，當此一現象發生時，釋放之電子成為自由電子，可移動至晶體結構之其它部份，此離開之電子在外部殼層產生一空位，稱為電洞。電洞行為與正值電荷相似，會吸引與捕捉附近之電子。

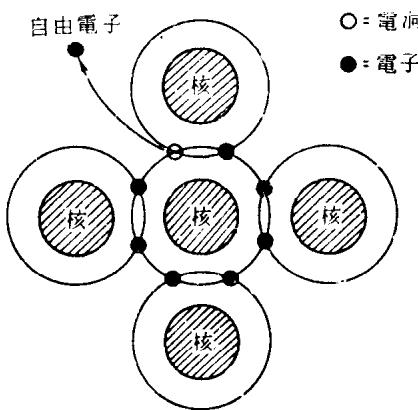


圖 1-5 產生電洞

在純鎵或矽之晶體中，熱能產生相同數量之自由電子與電洞，自由電子在整個晶體結構內隨意漂流，偶然地，一自由電子與電洞接近至某一程度時即被電洞所吸引與捕捉，當此一情形發生時，電洞消失，自由電子成為束縛電子 (*bound electron*)，此自由電子移向電洞之行為稱之再結合 (*recombination*)。

在任何一瞬間，晶體內有下列事件發生：

- 1 藉熱能而產生自由電子與電洞。
- 2 自由電子與電洞之再結合。

6 電晶體電路

3 一些自由電子與電洞存在於二階段之間；此即，它們先前產生但並沒有再結合。這些自由電子與電洞，在再結合之前所存在的平均時間 (*average time*) 稱為生命期 (*life time*)。

實際上在半導體中可能有兩部份電流；其一為自由電子之移動，另一為電洞之移動。自由電子之移動在 1-3 節已簡短的討論過，並由圖 1-4 予以說明。

電洞同樣移動。為瞭解其如何發生，可注意圖 1-6，在最右邊顯示一單一之電洞，電洞之緊鄰位置 A 處為一束縛電子，此束縛電子受電洞吸引，移向電洞。當此現象發生時，原有電洞消失，在 A 處產生一新電洞。在 A 處之新電洞現在可吸引並捕捉在 B 處之束縛電子，因而形成，A 處之電洞消失，而 B 處出現一新電洞。此程序可繼續進行，束縛電子如箭頭所示隨意移動。因此，電洞由一原子移至另一原子處。注意：電洞移動方向與束縛電子相反。

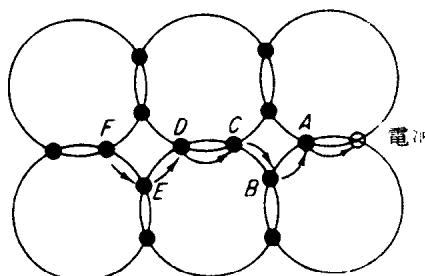


圖 1-6 電洞移動

無電場時，電洞隨意移動，即電洞可在所有方向移動，因此在任何方向，無淨電流。假如電場存在於晶體內，在電場方向產生淨電流，例如圖 1-7 電池連接在純半導體兩端，熱所產生之電洞與自由電子各以正負號表示。因為電池極性關係，自由電子移向左邊，電洞移向右邊。當然有一些電洞與自由電子再結合，但是自由電子與電洞繼續由熱能產生，所以在任何時間內，均有一些自由電子與電洞能夠參加電流活動。

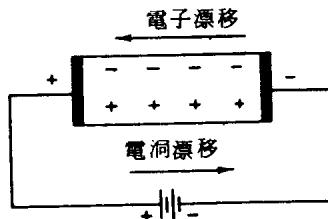


圖 1-7 電流部份

注意圖 1-7 之兩部份電流，自由電子向左邊漂移為此電流之一部份。當電子到達半導體左端，它們被金屬板吸收，進入電池正端。同時，電池負端向半導體右端注入自由電子，而維持一連續之自由電子活動。電洞向右邊移動為此電流之第二部份。當電洞到達半導體右端，電池中之電子與這些電洞結合，成為束縛電子。同時，在晶體內部由熱能產生新電洞，因此可維持連續電洞活動。

嚴格說來，電洞並非正電荷，而係原子外部殼層產生的空位。但因許多實驗，如霍爾效應 (*Hall effect*)，指出電洞移動，且其行為如同正電荷。因為這種理由，我們用正號代表電洞，並想像它為正電荷。

I — 5 外質(extrinsic)半導體

在純質半導體內，由熱能所產生之自由電子與電洞數量太少，無任何實用價值。但可由摻雜程序增加自由電子與電洞數量。此即意味我們可在銻與矽晶體中加入雜質原子 (*impurity atom*)。半導體被摻雜稱為外質半導體；半導體仍為純質，或未被摻雜，稱為本質半導體 (*intrinsic semiconductor*)。

一種摻雜純銻(或矽)之方法，首在熔解以破壞晶體之結構，而後摻入少量之外部殼層為五個電子的元素(為磷—*phosphorus*，砷—*arsenic* 和鎵—*antimony*等，此處稱之謂雜質元素)。假設